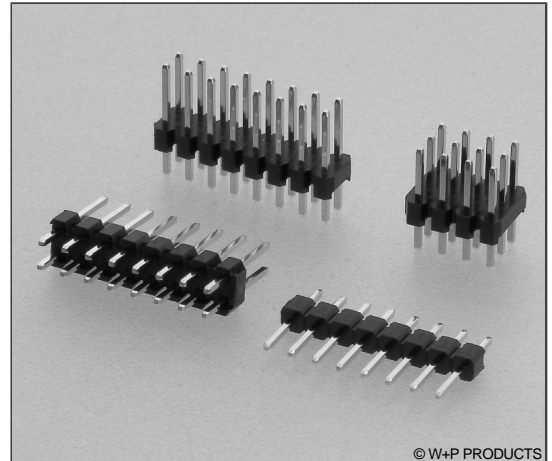


# 943 / 944 / 945

Stiftleisten RM 2,54mm, gerade, 1-/2-/3-reihig  
Pin Headers, 2.54mm Pitch, Straight, 1/2/3 Rows

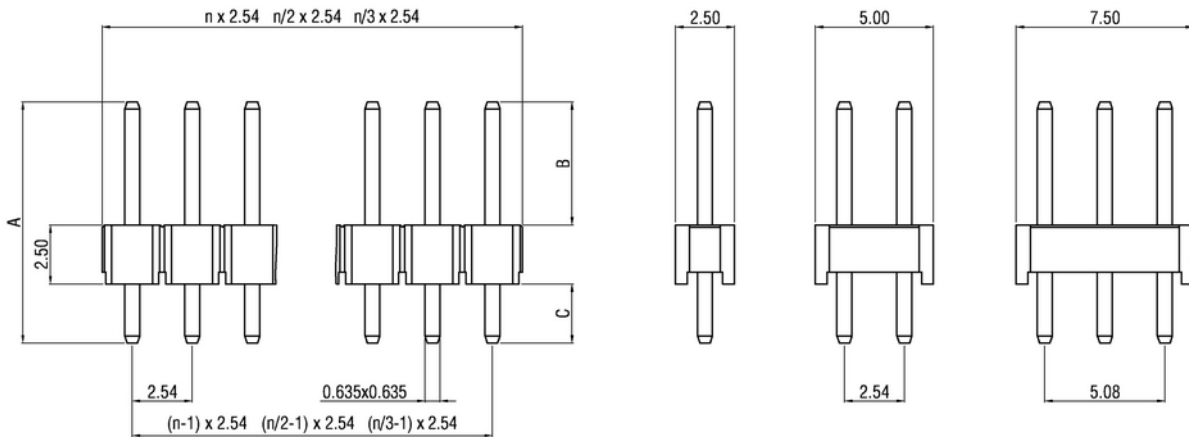
## Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>0.635mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ <i>&lt; 20mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>&gt; 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV <sub>DC</sub> <i>1kV<sub>DC</sub></i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250V <sub>AC</sub> <i>250V<sub>AC</sub></i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3A <i>3A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +125°C <i>-40°C ... +125°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
*Compatible Female Headers:*  
153 154 157 159 160/162 349 624 etc.  
Weitere siehe Kapitel B  
*see ch. B for more*



PCB Layouts und Detailzeichnungen s. tech. Informationen / Seite A12  
*Please note tech. information / page A12 for PCB layouts and detailed drawings.*

### Series \*

**944**

**Gestanzte/geprägte Kontakte**  
*Stamped/formed contacts*  
943 Einreihig  
*Single row*  
944 Zweireihig  
*Double row*  
945 Dreireihig  
*Triple row*

### Dimensions \*

**10**

10 A=10,20 B=5,20 C=2,50mm  
11 A=10,80 B=5,80 C=2,50mm  
12 A=11,30 B=5,50 C=3,30mm  
13 A=12,60 B=6,80 C=3,30mm  
14 A=13,90 B=8,10 C=3,30mm  
15 A=14,70 B=8,90 C=3,30mm  
16 A=17,70 B=11,90 C=3,30mm  
17 A=19,80 B=14,00 C=3,30mm  
18 A=21,60 B=15,80 C=3,30mm  
19 A=22,80 B=17,00 C=3,30mm  
20 A=24,90 B=19,10 C=3,30mm  
**A [mm]** Kundenspezifisch (max. 72,5mm)  
*Customer-specific (max. 72,5mm)*

### Contacts \*

**010**

001-050 Einreihig  
*Single row*  
004-100 Zweireihig  
*Double row*  
009-120 Dreireihig  
*Triple row*

### Plating \*

**00**

00 Vergoldet  
*Gold plated*  
110 Sel. Au 0,25µm / flash  
130 Sel. Au 0,75µm / flash  
50 Verzinkt  
*Tin plated*  
66 Sel. Au / Sn  
610 Sel. Au 0,25µm / Sn  
80 Sel. Au 0,75µm / Sn  
**Au flash = min. 0,025µm**

Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl.  
Raster 5,08mm, 7,62mm, etc. oder Sonderraster sowie  
weitere Stiftlängen und Abmessungen auf Anfrage.  
Bestellseite "Sonderbestückungen bei Stiftleisten" unter  
Techn. Informationen.

*We will manufacture the pin headers in every desired number of contacts. 5.08mm, 7.62mm, etc. and varying pitches as well as more dimensions on request. Order page "Customer-specific Pin Configurations" in Technical Information.*

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

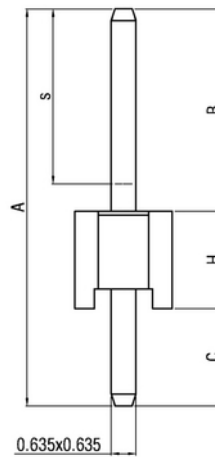
# Stiftleistenmaße und PCB Layouts für 0,635mm Vierkantstifte

## Dimensions and PCB Layouts

### Gerade Stiftleisten / Straight Pin Headers

- A : Gesamstiftlänge / Overall Pin Length
- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

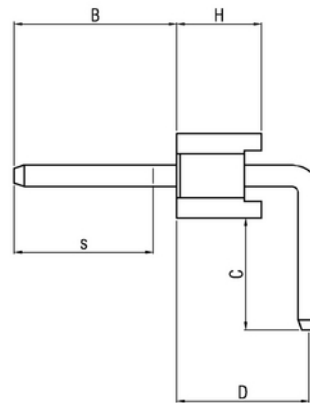
Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.  
 Test point for s at 2-4mm from contact tip.



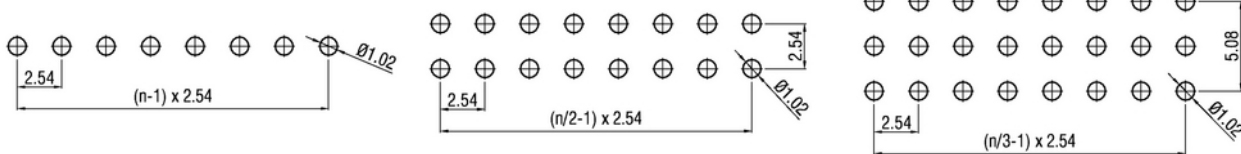
### Gewinkelte Stiftleisten / Right-Angled Pin Headers

- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- D : Abstand zu Steckseite / Distance to Mating Side
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.  
 Test point for s at 2-4mm from contact tip.



### PCB Layouts

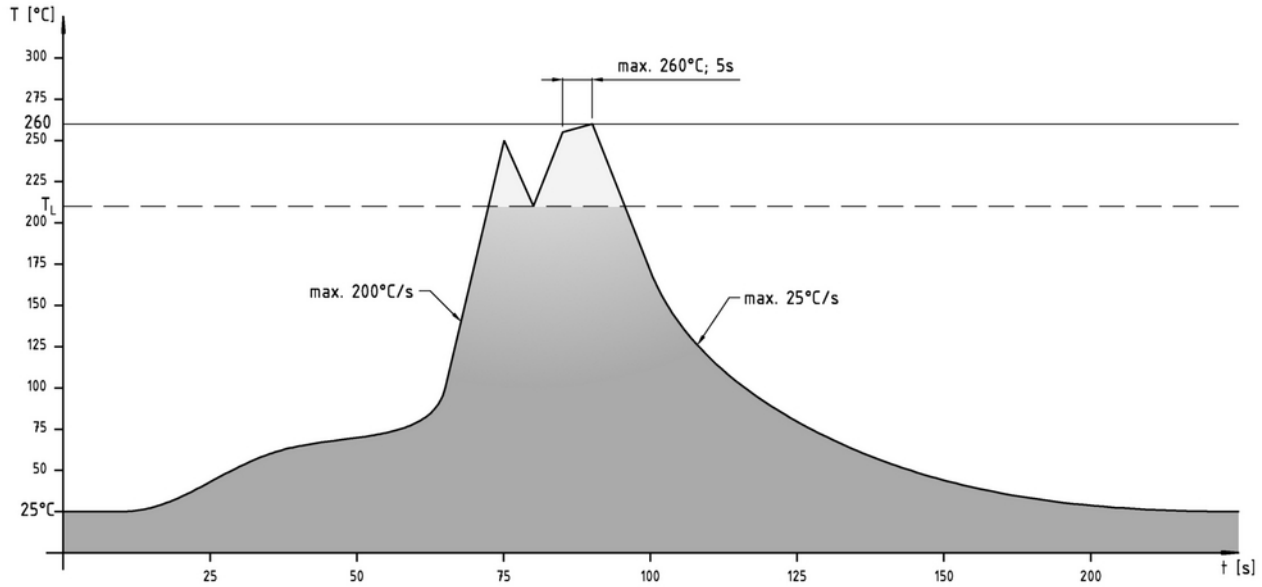


## Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.  
*Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.*

Empfohlenes Wellenlötprofil:  
*Recommended wave soldering profile:*



# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

